

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年5月30日(30.05.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/111501 A1

(51) 国際特許分類:

B22F 1/00 (2022.01) B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/10 (2022.01) C09J 9/02 (2006.01)
B22F 1/0545 (2022.01) H01B 1/22 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/041276

(22) 国際出願日: 2023年11月16日(16.11.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
PCT/JP2022/043409 2022年11月24日(24.11.2022) JP

(71) 出願人: 花王株式会社(KAO CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場
町一丁目14番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 江山 誉昭(EYAMA Takaaki); 〒6408580
和歌山県和歌山市湊1334番地 花王株式
会社研究所内 Wakayama (JP). 鈴木 佑京(SUZUKI
Ukyo); 〒6408580 和歌山県和歌山市湊13
34番地 花王株式会社研究所内 Wakayama
(JP). 武藤 功甫(MUTO Kosuke); 〒6408580 和
歌山県和歌山市湊1334番地 花王株
式会社研究所内 Wakayama (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI
PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎
ノ門三丁目25番2号 虎ノ門E S
ビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: COPPER NANOPARTICLE-CONTAINING COMPOSITION

(54) 発明の名称: 銅ナノ粒子含有組成物

(57) Abstract: The present invention relates to: a copper nanoparticle-containing composition that contains copper nanoparticles A, a monocarboxylic acid B, and an organic solvent C, wherein the monocarboxylic acid B has 5 to 12 carbon atoms, and the monocarboxylic acid B has at least one functional group or bond selected from the group consisting of a hydroxy group, a ketonic carbonyl group, and an ether bond; a method for producing a joined body using said copper nanoparticle-containing composition; and a joined body or electronic device using said copper nanoparticle-containing composition.

(57) 要約: 本発明は、銅ナノ粒子A、モノカルボン酸B、及び有機溶媒Cを含有し、該モノカルボン酸Bの炭素数が5以上12以下であり、該モノカルボン酸Bがヒドロキシ基、ケトン性カルボニル基、及びエーテル結合からなる群から選ばれる1種以上の官能基又は結合を有する、銅ナノ粒子含有組成物、該銅ナノ粒子含有組成物を用いる接合体の製造方法、及び該銅ナノ粒子含有組成物を用いた接合体又は電子デバイスに関する。

WO 2024/111501 A1